

【原因・判断ポイント・発生工程】微細な繊維などがスルーホール内や、銀ペースト内に介在し銀ペーストの充填を阻害して出来たもの（銀スルーホール印刷工程）

【原因、判断要点、発生工序】在通孔内或者银膏内夹杂细微的纤维，妨碍银膏的填充所引起的（银通孔印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
A fine fiber or the like that is present in the through hole or in silver paste prevents the complete filling of silver paste (Silver paste printing process)



【コメント】
銀ペースト充填不足による表面銅導体との断線
顕微鏡倍率×50

【注釋】
银膏填充不足引起的表面铜导线的开路
显微镜倍率×50

【Comments】
The discontinuity between silver paste through-hole and surface conductor caused by insufficient paste filling.
Magnification: ×50

5-2-2 銀スル首部ペースト厚過剰／银通孔颈的银膏过剩／ Excessive silver paste thickness at hole neck

【特徴】銀ペーストの厚さがスルーホール首部で異常に厚くなっている状態の欠陥

【特征】在银通孔勃颈的银膏非常厚的缺陷。

【Characteristics】Silver paste is unusually thick at the neck of a through hole.

【原因・判断ポイント・発生工程】銀ペースト粘度異常により出来たもの（銀スルーホール形成工程）

【原因、判断要点、発生工序】銀膏の粘度異常所造成的（银通孔形成工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by an abnormally high viscosity of silver paste (Silver through hole formation process)



【コメント】
顕微鏡倍率×20

【注釋】
显微镜倍率×20

【Comments】
Magnification: ×20



【コメント】
顕微鏡倍率×20

【注釋】
显微镜倍率×20

【Comments】
Magnification: ×20

5-2-3 銀スルオーバーコートズレ／银通孔的表面涂层的偏移／ Displaced overcoat silver of through hole

【特徴】銀スルーホール用オーバーコートがズレて銀ペースト部の一部が露出している状態の欠陥

【特征】银通孔的表面涂层偏移，局部露出银膏的缺陷。

【Characteristics】A part of silver pasted area is exposed due to a displaced overcoat.



【コメント】
顕微鏡倍率×20

【注釋】
显微镜倍率×20

【Comments】
Magnification: ×20